

## ■ 鍍金機收費辦法：

### 一、自行操作：

(1) SEM/ EDS：使用費每小時 250 元，以小時為單位計費。

鍍金機：使用費每分鐘 300 元，以分鐘為單位計費，

不足 1 分鐘仍以 1 分鐘計費，白金靶材由本系提供。

； 通常每次都鍍 1min~1.5min；約 5~10nm 表面鍍膜厚度

(2)每年統計各老師累計之使用費，並自本系分配各教師之業務費

或設備費（原則上業務費不足額時，則逕扣教師類推之經費順

序【設備費、管理費、技術服務費】等）扣款。

### 二、委託操作：

(1) SEM/ EDS：

使用費每小時 500 元，至少 3 小時起計，並以小時為單位計費。

鍍金機：使用費每分鐘 500 元，以分鐘為單位計費，

不足 1 分鐘仍以 1 分鐘計費，白金靶材由本系提供。

(2)自本校單位業務費扣款。

(3)校內其他單位一律委託操作，系內需經認證考核後得可自行操

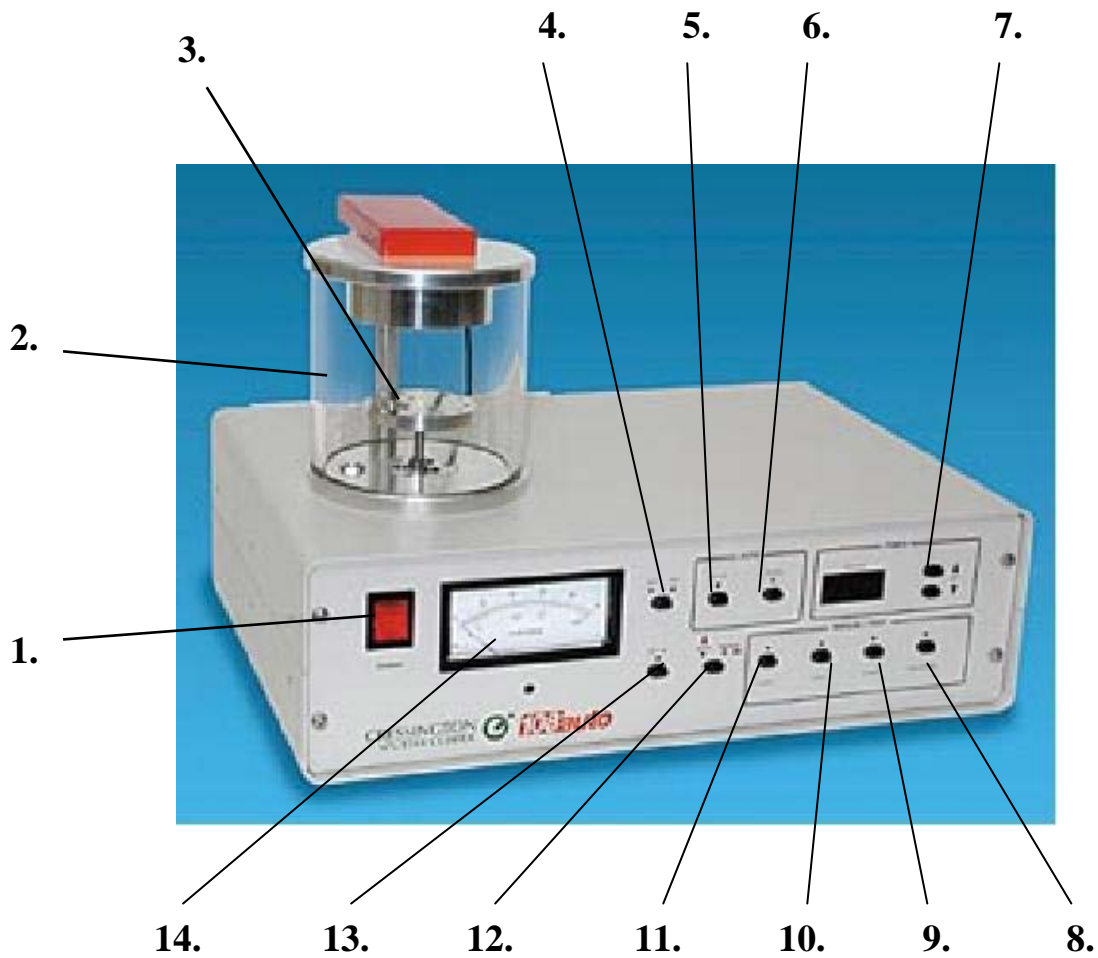
作；特殊試片須經機台保管人之同意，避免污染腔體，系內認

證資格需為本系學生。

# Sputter Coater 108 auto

## 鍍金機操作手冊

一、



(圖示一)

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. 總電源        | 8. 手動暫停與時間選擇按鍵 |
| 2. 玻璃罩        | 9. 手動啟動按鍵      |
| 3. 試片座        | 10. 洩氣按鍵       |
| 4. ma/mb 選擇按鍵 | 11. 充溢按鍵       |
| 5. 自動程式按鍵     | 12. 自動與手動選擇按鍵  |

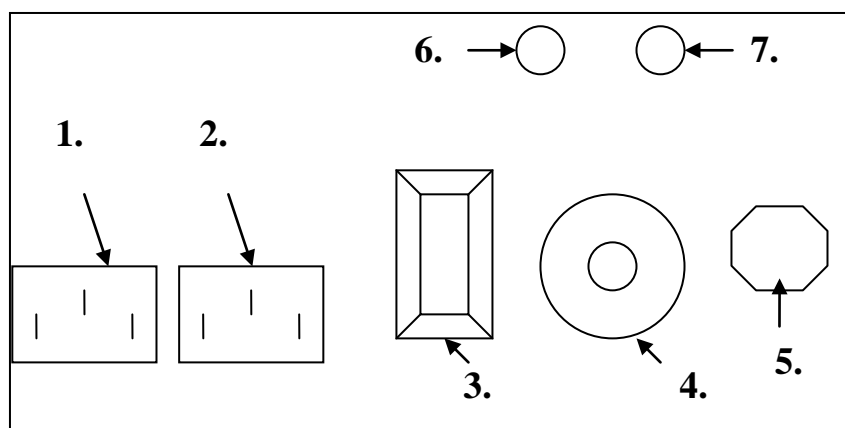
6. 終止按鍵 ( 暫停 )

13. 電流選擇按鍵

7. 調整按鍵

14. 電流指示錶

二、



(圖示二)

1. 主電源

2. PUMP 電源

5. Ar.N2 氣體流量控制閥

3. 保險開關

6. Ar.氣閥

4. 真空幫浦接口處

7. N2.氣閥

三、

- 手動：自己控制抽氣壓力、洩氣壓力、進氣量、以及擊發時的真空壓力大小。
- 自動：按下自動選擇鍵，機台會自動依照設定做完上述動作，並可一直重複使用同一動作。

以下為操作機台之步驟：

1. 將試片放在試片座上。
2. 蓋上玻璃罩。
3. 開啟真空幫浦抽真空。
4. 押住圖示一（13）電流選擇按鍵及（7）調整按鍵，選擇所需的擊發電流大小（分別為 10、20、30、40 四種電流之選擇）。
5. 押住圖示一（8）時間按鍵及（7）調整按鍵，調整選擇所需的擊發時間長短（範圍為 0~300 秒）。
6. 如果選擇按下自動模式按鍵，以下會自動執行鍍膜程序。
7. 如果選擇手動模式就必須依照自我設定之真空壓力、進氣量、洩氣壓力、擊發時真空大小，依照選擇按鍵。
8. 先關閉電源再關閉真空幫浦，即可解除真空取出試片。

四、

此種機型無法偵測膜厚，若需知道鍍膜之厚度需搭配石英膜厚偵測計，才可獲得鍍膜之厚度。



### **Model MTM-10**

可偵測顯示鍍膜厚度。

### **Model MTM-20**

可偵測控制鍍膜厚度及  
設定鍍膜終止時間。